

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。由於本節內容為概要，並未包括可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下決定[編纂][編纂]前，務請閱讀整份文件。

任何投資均涉及風險。[編纂][編纂]的若干特定風險載於「風險因素」一節。閣下決定[編纂][編纂]前，務請細閱該節。

概覽

我們是中國領先的國產平台化芯片定制服務提供商，專注於AI ASIC的研發和商業化。憑藉我們自主研發的IC技術平台和專有高速接口IP，我們定制的AI ASIC能夠解決數據傳輸瓶頸，實現大規模AI芯片集群的高效互聯，旨在人工智能應用中達到算力利用率的最大化。根據灼識諮詢的資料，按2025年AI ASIC收入計算，我們在中國國產芯片定制服務提供商中排名第三，且按2025年芯片設計及交付收入計算，我們在中國國產芯片定制服務提供商中排名第二。

我們的芯片定制服務

我們的芯片定制服務由芯片設計、芯片交付及IP授權組成。芯片設計涵蓋芯片定義、前端設計、後端設計、流片、硅後支持及客戶產品化賦能。芯片交付涵蓋晶圓級硅片驗證、先進封裝與測試以及供應鏈協同。

芯片定制服務委託可從芯片設計開始（無論是否包含IP授權），並可能隨後進行芯片交付。芯片設計及芯片交付為我們的主要收入來源，於2023年、2024年及2025年的合計收入貢獻分別為83.9%、73.3%及91.0%。

下表載列往績記錄期間按業務線劃分的收入明細。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)					
芯片設計.....	41,259	55.1	231,505	66.6	203,228	42.0
芯片交付.....	21,525	28.8	23,353	6.7	237,597	49.0
IP授權.....	12,018	16.1	92,698	26.7	43,371	9.0
總計.....	74,802	100.0	347,556	100.0	484,196	100.0

我們的收入由2023年的人民幣74.8百萬元大幅增至2024年的人民幣347.6百萬元，並進一步增加39.3%至2025年的人民幣484.2百萬元。然而，往績記錄期間各業務線的收入波動，乃受任何特定年度的芯片定制服務委託的服務組合及實際進度影響。自2023年至2024年，芯片設計收入及IP授權收入大幅增加，而芯片交付收入增加8.5%，主要是由於多個新項目於2024年完成設計階段，但尚未達到或完成交付階段。自2024年至2025年，芯片交付收入大幅增加，成為2025年最大收入貢獻者，而芯片設計收入及IP授權收入均有所減少，乃主要由於多個現有項目於2025年進入交付階段。

概 要

下表載列往績記錄期間按服務應用類型劃分的收入明細。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)					
AI ASIC	38,658	51.7	314,932	90.6	437,262	90.3
通信ASIC	35,421	47.4	32,624	9.4	46,934	9.7
其他	723	0.9	—	—	—	—
總計	74,802	100.0	347,556	100.0	484,196	100.0

我們的AI ASIC收入由2023年的人民幣38.7百萬元大幅增加至2024年的人民幣314.9百萬元，並進一步增加38.8%至2025年的人民幣437.3百萬元。於2023年、2024年及2025年，我們的AI ASIC收入分別佔我們總收入的51.7%、90.6%及90.3%。於往績記錄期間，AI ASIC收入在絕對金額及佔總收入百分比方面的增長，反映了我們對AI ASIC定制服務的專注及投入。

我們的平台化模式

我們利用模塊化、智能化、自動化的IC技術平台，整合我們的設計能力與上下游資源，提供端到端的芯片定制服務。我們開發並授權專有高速接口IP，設計並定制採用先進工藝節點及2.5D/3D封裝的ASIC，並透過與第三方晶圓代工廠及OSAT夥伴合作交付芯片。在此模式下，我們主導從芯片架構設計、邏輯設計、可測性設計、物理設計到全生命週期管理的整個過程，並與晶圓製造、封裝測試領域的業務夥伴高效協同，確保覆蓋從4納米到28納米的工藝節點。

我們的平台化模式由以下核心特點定義。

- **IP複用與效率**：透過我們的模塊化IP庫和成熟的設計方法論，我們提供的芯片定制服務兼具設計效率、品質一致性與交付速度。
- **無縫的一站式服務**：從架構設計到芯片交付，我們最大限度減少多階段、多方協作帶來的負擔和潛在風險，確保項目進度。
- **快速跨領域擴展**：我們的平台化模式支持跨越多個領域（如AI和通信）的技術遷移，幫助客戶開拓新的應用場景。
- **基於經驗的專業知識積累**。儘管工藝節點持續迭代，我們的IC技術平台使我們能夠積累專業知識並豐富我們的設計工具鏈，從而增強我們識別及降低項目風險的能力，最終提高項目成功率。

我們的優勢

我們認為以下優勢使我們從競爭對手中脫穎而出：

- 中國領先的國產一站式AI ASIC定制服務提供商，擁有先進的IC技術平台；

概 要

- 以自主開發的專有高速接口IP為核心的IC技術平台；
- 領先的複雜芯片設計與先進物理實現技術能力，精準匹配高端市場需求；
- 與全球及國內產業鏈建立強大的業務協作，構建穩定交付體系；及
- 經驗豐富、擁有深厚行業背景並具備國際視野的團隊。

有關詳情，請參閱「業務－我們的優勢」。

我們的戰略

我們致力於通過以下戰略舉措提升我們的行業地位並實現卓越的業務增長：

- 持續擴大專有高速接口IP組合，鞏固IC技術平台的根基；
- 構建開放協作的AI硬件生態系統，打造國產AI ASIC新標桿；
- 加強與晶圓代工生態系統的合作，構建雙軌工藝協同體系；及
- 實施全球化戰略佈局，構建開放包容的IC生態系統。

有關詳情，請參閱「業務－我們的戰略」。

盈利路徑

於2023年、2024年及2025年，我們的虧損淨額分別為人民幣98.4百萬元、人民幣48.5百萬元及人民幣163.5百萬元，因為我們一直為確立及保持在AI ASIC領域的市場地位而進行大量投資。於往績記錄期間，我們一直在擴大芯片設計及芯片交付的規模，並向先進工藝節點遷移。截至2025年12月31日，我們的研究與技術團隊由317名工程師及其他技術人員組成，佔僱員總數的81.7%。於2023年、2024年及2025年，我們的研發開支分別為人民幣90.9百萬元、人民幣175.5百萬元及人民幣239.0百萬元，分別佔總收入的121.5%、50.5%及49.4%。我們持續開發並維持專有高速接口IP組合，包括112/224 Gbps SerDes、HBM3/HBM3e、LPDDR5x/LPDDR6及芯粒互聯技術，這需要持續的資金投入，以吸引頂尖人才及購置先進EDA工具與原型設計資源。此外，我們透過以下方式投資建設模塊化、智能化及自動化IC技術平台：(i)開發專有設計方法；及(ii)積累可重用IP庫。該等投資對保持我們芯片定制服務的競爭力至關重要，但亦導致我們在發展相對早期階段產生較高的初始經營開支。

儘管我們於往績記錄期間錄得歷史虧損淨額，但隨著IC技術平台持續迭代並趨於成熟，我們的毛利已提升。隨著我們的收入由2023年的人民幣74.8百萬元大幅增加至2024年的人民幣347.6百萬元，我們的毛利由2023年的人民幣26.1百萬元大幅增加至2024年的人民幣160.3百萬元。儘管收入由2024年的人民幣347.6百萬元增長至2025年的人民幣484.2百萬元，但毛利由2024年的人民幣160.3百萬元減少至2025年的人民幣134.3百萬元，該收入增長與毛利增長之間的錯配主要是由於(i)芯片設計的毛利由2024年的人民幣94.4百萬元減至2025年的人民幣32.5百萬元，及

概 要

芯片交付的毛利由2024年的人民幣4.4百萬元增至2025年的人民幣65.7百萬元，令2024年及2025年芯片設計及芯片交付兩者的毛利穩定；及(ii)IP授權的毛利由2024年的人民幣61.5百萬元減至2025年的人民幣36.2百萬元。於往績記錄期間的歷史虧損淨額反映我們為在快速擴張的市場中獲取份額而採取的深思熟慮戰略，而非運營低效。

我們擬主要透過以下措施制定清晰、可持續的盈利路徑。

把握日益增長的AI計算需求。 AI ASIC對於AI計算的持續擴張至關重要。根據灼識諮詢的資料，按收入計，中國AI ASIC定制服務市場的規模由2020年的人民幣44.2億元增加至2025年的人民幣345.8億元，並預計將於2030年達到人民幣2,057.3億元，2025年至2030年的複合年增長率為42.9%。根據灼識諮詢的資料，按2025年的芯片設計及交付收入計，我們在中國國內芯片定制服務提供商中排名第二。我們擬利用我們的市場地位捕捉市場增長潛力，並把握我們在先進工藝節點下ASIC設計、2.5D/3D先進封裝設計以及專有高速接口IP授權方面的技術優勢，以及數據中心AI、邊緣AI及高性能計算市場的發展機遇，此將促進我們收入的持續增長。

聚焦大客戶。 我們一直聚焦大客戶以擴大收入基礎並提升毛利增長潛力。我們將我們於某一年度自其產生收入達人民幣10.0百萬元或以上的客戶界定為大客戶。根據灼識諮詢的資料，客戶集中度在芯片定制服務行業中屬常見，尤其是在AI ASIC領域。我們於往績記錄期間的收入及毛利增長印證了我們大客戶聚焦策略的初步成效。隨著我們邁入下一發展階段，我們將加大對大客戶的聚焦，提升各名大客戶的變現深度及廣度，旨在基於圍繞大客戶的可擴展性構建盈利模式。展望未來，我們將(i)挖掘現有大客戶的需求並與其共同成長，圍繞大客戶需求持續推進技術迭代及服務升級，(ii)持續拓展大客戶組合並進一步優化客戶結構，及(iii)藉助大客戶的前沿需求及時引導技術創新及迭代方向，我們認為此舉將提升研發效率及成效，從而推動我們向高質量、以盈利為導向的增長發展。

優化服務組合及拓展芯片交付。 我們將逐步擴大芯片交付業務，以推動實現盈利能力。受益於在芯片設計過程中建立的緊密協作關係及客戶忠誠度，芯片交付通常無需額外銷售及營銷資源即可獲取訂單，亦無需在研發方面進行大規模的新投資。該利潤結構使芯片交付成為我們的核心增長引擎及高質量利潤潛力的來源。

強化一站式服務能力。 通過提供一站式服務，我們可滿足客戶多樣化及多層次的業務需求，提供高附加值服務，從而提升經營穩定性及抗風險能力。同時，我們依託IC技術平台持續積累並迭代技術實力。設計與供應鏈資源的長期積累，結合未來持續的芯片定制服務委託，將顯著提升我們的整體成本效益及綜合競爭力。此外，我們將持續加強與核心供應商的長期合作，以構建穩定可靠的供應體系。通過強化供需協同，我們將提升採購規模及議價能力，確保關鍵材料的穩定、高效及具成本效益供應，並推動單位成本穩步下降。同時，我們將進一步優化存貨周轉及全週期供應鏈管理，提升供應鏈響應能力及運營效率，確保芯片交付能力持續優化。

概 要

提升經營效率。我們將嚴格控制經營開支，優化資源配置結構，持續完善技術基礎設施，並推進全面數字化建設。鑒於AI行業快速迭代，我們採取積極擴張策略，發揮研發、項目執行及銷售與營銷等核心職能之間的協同效應，構建高效運營體系。

有關進一步詳情，請參閱「財務資料－盈利路徑」。

客戶及供應商

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括AI、通信及其他行業的芯片及系統供應商。於2023年、2024年及2025年，我們的五大客戶於各適用年度產生的收入分別佔我們總收入的74.4%、95.1%及78.3%，而我們的最大客戶於各適用年度產生的收入分別佔我們總收入的32.2%、81.5%及37.4%。

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括：(i)流片服務及晶圓供應商，(ii)第三方IP供應商，及(iii)半導體封裝材料供應商。於2023年、2024年及2025年，我們的五大供應商於各適用年度的採購額分別佔我們總採購額的65.2%、85.7%及65.1%；最大供應商於各適用年度的採購額分別佔我們總採購額的28.1%、48.7%及22.9%。於往績記錄期間，我們的採購主要來自中國和韓國的供應商。

風險因素

[編纂]我們的H股涉及若干風險。該等風險的特徵可分為(i)與我們的業務及行業有關的風險；(ii)與在我們營運所在司法權區經營業務有關的風險；及(iii)與[編纂]有關的風險。我們認為我們所面臨最重大的風險包括：

- 我們在競爭激烈的芯片定制服務行業中經營業務，且我們未必能與現有及未來競爭對手成功競爭；
- 新技術發展或市場趨勢可能使我們失去競爭力，且我們的大量研發投入未必能產生預期結果；
- 有關AI芯片開發的不確定因素可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響；
- 對有限數量供應商的依賴以及半導體材料與製造服務的潛在短缺或產能限制，可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
- 我們的經營歷史有限，因此難以預測我們未來的經營業績，而我們的歷史增長未必反映我們的未來表現；
- 我們的客戶集中度可能使我們面臨風險，進而對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響；
- 我們使用自第三方獲得授權的IP以補充我們的服務。該等第三方IP的任何缺陷、錯誤或限制，或未能維持該等授權，均可能對我們的業務造成重大不利影響；
- 我們未必能在全球範圍內充分保護或執行我們的知識產權，且為此所作的努力可能成本高昂；

概 要

- 我們可能面臨知識產權侵權索賠或其他法律程序，這可能會對我們的業務造成不利影響；及
- 我們依賴稱職人才的持續貢獻。倘我們無法吸引及留住支持現有營運及未來增長的稱職人才，我們的業務可能會受到重大不利影響。

歷史財務資料概要

下表呈列我們於往績記錄期間的綜合財務資料概要並應連同本文件附錄一會計師報告所載我們的綜合財務報表及相關附註以及「財務資料」所載的資料一併閱讀。

經營業績概要

下表載列我們於所示期間的綜合損益表。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)					
收入	74,802	100.0	347,556	100.0	484,196	100.0
銷售成本	(48,705)	(65.1)	(187,264)	(53.9)	(349,853)	(72.3)
毛利	26,097	34.9	160,292	46.1	134,343	27.7
其他收入及收益	7,220	9.5	19,600	5.6	16,573	3.3
銷售開支	(3,907)	(5.2)	(11,158)	(3.2)	(26,264)	(5.4)
行政開支	(35,563)	(47.5)	(40,382)	(11.6)	(48,626)	(10.0)
研發開支	(90,868)	(121.5)	(175,536)	(50.5)	(239,033)	(49.4)
金融資產減值收益／ (虧損)淨額	512	0.7	(314)	(0.1)	(194)	(0.0)
其他開支	(109)	(0.1)	(689)	(0.2)	(113)	(0.0)
融資成本	(1,812)	(2.4)	(239)	(0.1)	(196)	(0.0)
除稅前虧損	(98,430)	(131.6)	(48,426)	(13.9)	(163,510)	(33.8)
所得稅開支	—	—	(33)	(0.0)	—	—
年內虧損	(98,430)	(131.6)	(48,459)	(13.9)	(163,510)	(33.8)
歸屬於：						
母公司擁有人	(98,430)	(131.6)	(48,459)	(13.9)	(163,510)	(33.8)
年內虧損	(98,430)	(131.6)	(48,459)	(13.9)	(163,510)	(33.8)

收入

有關我們於往績記錄期間按業務線及按服務應用類型劃分的收入明細，請參閱「一概覽－我們的芯片定制服務」。

概 要

毛利及毛利率

下表載列於所示期間我們按業務線劃分的毛利及毛利率明細。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)					
芯片設計.....	11,940	28.9	94,448	40.8	32,477	16.0
芯片交付.....	2,139	9.9	4,380	18.8	65,657	27.6
IP授權.....	12,018	100.0	61,464	66.3	36,209	83.5
總計	26,097	34.9	160,292	46.1	134,343	27.7

我們的毛利由2023年的人民幣26.1百萬元大幅增至2024年的人民幣160.3百萬元，乃主要由於(i)芯片設計的毛利由2023年的人民幣11.9百萬元大幅增至2024年的人民幣94.4百萬元；及(ii) IP授權的毛利由2023年的人民幣12.0百萬元大幅增至2024年的人民幣61.5百萬元，與2023年至2024年芯片設計及IP授權推動的收入增長一致。我們的毛利由2024年的人民幣160.3百萬元減至2025年的人民幣134.3百萬元，乃主要由於(i)芯片設計的毛利由2024年的人民幣94.4百萬元減至2025年的人民幣32.5百萬元，及芯片交付的毛利由2024年的人民幣4.4百萬元增至2025年的人民幣65.7百萬元，令2024年及2025年芯片設計及芯片交付兩者的毛利穩定；及(ii) IP授權的毛利由2024年的人民幣61.5百萬元減至2025年的人民幣36.2百萬元。

IP授權的毛利率通常高於芯片設計及芯片交付的毛利率。IP授權的毛利率於2023年為100%，此乃由於授權的IP是我們IP庫的現有IP，其開發支出於過往年度已入賬至研發開支項下。IP授權的毛利率於2024年為66.3%，於2025年為83.5%，主要是由於授權定制化程度更高的IP，其開發支出已入賬至2024年及2025年的銷售成本項下。於2023年及2024年芯片交付的毛利率低於芯片設計的毛利率，原因是2023年及2024年我們的芯片交付產能處於爬坡階段，規模較小。於2025年芯片交付的毛利率高於芯片設計的毛利率，原因是(i) 2025年芯片交付規模大幅擴展，提高了其利潤率狀況及(ii) 2025年芯片設計的毛利率減少，原因是我們在先進工藝節點下的芯片設計委託增加，就此我們產生不成比例的更多晶圓流片材料成本。我們的整體毛利率由2023年的34.9%增至2024年的46.1%，乃主要由於(i)芯片設計及IP授權共同收入貢獻由2023年的71.2%增至2024年的93.3%及(ii)芯片設計的毛利率由2023年的28.9%增至2024年的40.8%。我們的整體毛利率由2024年的46.1%回落至2025年的27.7%，乃主要由於芯片設計的毛利率由2024年的40.8%減至2025年的16.0%，部分被芯片交付的毛利率由2024年的18.8%增至2025年的27.6%所抵銷。

概 要

綜合財務狀況表概要

下表載列截至所示日期我們綜合財務狀況表的概要。

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
		(人民幣千元)	
流動資產總值	600,980	601,897	370,442
非流動資產總值	77,666	79,195	83,075
資產總值	678,646	681,092	453,517
流動負債總額	413,244	437,505	307,573
非流動負債總額	1,488	808	1,377
負債總額	414,732	438,313	308,950
流動資產淨值	187,736	164,392	62,869
資產淨值	263,914	242,779	144,567
實繳資本	10,168	11,518	14,860
儲備	253,746	231,261	129,707
權益總額	263,914	242,779	144,567

截至2023年、2024年及2025年12月31日，我們的流動資產淨值分別為人民幣187.7百萬元、人民幣164.4百萬元及人民幣62.9百萬元。我們截至該等日期的流動資產淨值狀況主要歸因於預付款項、其他應收款項及其他資產、現金及現金等價物、存貨以及按公允價值計入損益計量的投資，部分被合約負債所抵銷。

我們的流動資產淨值由截至2024年12月31日的人民幣164.4百萬元減少至截至2025年12月31日的人民幣62.9百萬元，主要由於(i)按公允價值計入損益計量的投資減少人民幣150.3百萬元及(ii)存貨減少人民幣87.6百萬元，部分被合約負債減少人民幣135.5百萬元所抵銷。

我們的流動資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣187.7百萬元減少至截至2024年12月31日的人民幣164.4百萬元，主要由於(i)按公允價值計入損益計量的投資減少人民幣205.4百萬元；(ii)其他應付款項及應計費用增加人民幣37.3百萬元，部分被以下各項所抵銷：(i)存貨增加人民幣94.8百萬元；(ii)預付款項、其他應收款項及其他資產增加人民幣70.0百萬元；及(iii)現金及現金等價物增加人民幣38.8百萬元。

有關詳情，請參閱「財務資料－有關綜合財務狀況表若干關鍵項目的討論」。

概 要

綜合現金流量表概要

下表載列於所示期間我們的綜合現金流量表概要。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)		
經營活動所得／(所用) 現金流量淨額.....	139,954	(128,506)	(158,317)
投資活動(所用)／所得現金流量淨額.....	(353,156)	183,943	116,144
融資活動所得／(所用) 現金流量淨額.....	264,009	(16,606)	44,647
現金及現金等價物增加淨額.....	50,807	38,831	2,474
於年初的現金及現金等價物.....	22,712	73,491	112,287
外匯匯率變動影響淨額.....	(28)	(35)	15
於年末的現金及現金等價物.....	73,491	112,287	114,776

有關詳情，請參閱「財務資料－流動資金及資本資源－現金流量」。

關鍵財務比率

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
毛利率(%).....	34.9	46.1	27.7
淨虧損率(%).....	(131.6)	(13.9)	(33.8)

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
流動比率 ⁽¹⁾ (倍).....	1.5	1.4	1.2
速動比率 ⁽²⁾ (倍).....	1.2	1.0	0.9
債務權益比率 ⁽³⁾ (%).....	7.3	1.2	13.6

附註：

- (1) 流動比率按流動資產總值除以流動負債總額計算。
- (2) 速動比率按流動資產總值減存貨再除以流動負債總額計算。
- (3) 債務權益比率按債務總額(包括計息銀行及其他借款及租賃負債)除以權益總額計算。

截至2023年、2024年及2025年12月31日，我們的流動比率及速動比率保持相對穩定。

我們的債務權益比率由截至2023年12月31日的7.3%下降至截至2024年12月31日的1.2%，主要由於償還銀行貸款導致截至2024年12月31日的債務總額減少所致。我們的債務權益比率進一步上升至截至2025年12月31日的13.6%，主要由於2025年錄得淨虧損導致權益總額減少所致。

概 要

申請在聯交所[編纂]

我們已向[編纂]申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）及將由境內非上市股份[編纂]而來的H股[編纂]及[編纂]，理由為（其中包括）我們符合上市規則第8.05(3)條項下的市值／收入測試，當中參考（其中包括）(i)我們於截至2025年12月31日止年度的收入超過500百萬港元，及(ii)我們於[編纂]時基於[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的下限）計算的預期市值超過上市規則第8.05(3)條規定的40億港元。

我們的控股股東

截至最後實際可行日期，王先生通過其於本公司持有的直接權益、王先生控制的實體及與其訂立一致行動協議的實體控制本公司約54.85%的投票權。緊隨股份拆細及[編纂]完成後，並假設於最後實際可行日期至[編纂]期間概無根據[編纂]發行新股份且本公司已發行股本概無其他變動，控股股東將有權共同控制本公司總投票權約[編纂]%的行使。因此，於股份拆細及[編纂]完成後，王先生及股巍電子將仍為我們的控股股東。有關詳情，請參閱「與控股股東的關係」。

[編纂]投資者

截至最後實際可行日期，我們已吸引若干[編纂]投資者並已完成七輪融資。有關[編纂]投資者背景及[編纂]投資主要條款的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構」。

[編纂]統計數據

下表載列的統計數據乃基於以下假設：(i)[編纂]已完成且通過[編纂]新發行[編纂]股H股；(ii)[編纂]的[編纂]未獲行使；及(iii)股份拆細及[編纂]完成後[編纂]股股份已發行及流通在外：

	按[編纂]每股股份 [編纂]港元計算	按[編纂]每股股份 [編纂]港元計算
H股市值 ⁽¹⁾	[編纂] 百萬港元	[編纂] 百萬港元
未經審計[編纂]經調整每股 有形資產淨值 ⁽²⁾	[編纂]港元 (人民幣[編纂]元)	[編纂]港元 (人民幣[編纂]元)

附註：

- (1) 市值乃根據緊隨股份拆細及[編纂]完成後預計將發行的[編纂]股股份計算得出。
- (2) 截至2025年12月31日未經審計[編纂]經調整每股有形資產淨值乃於作出本文件「附錄二－未經審計[編纂]財務資料」所述調整後計算得出。

有關股東應佔未經審計[編纂]經調整每股有形資產淨值的計算，請參閱本文件附錄二「未經審計[編纂]財務資料」一節。

概 要

未來計劃及[編纂]用途

經扣除[編纂]佣金及費用以及我們就[編纂]已付及應付的其他估計[編纂]開支後，假設[編纂]並無獲行使，並基於假設[編纂]為每股[編纂]港元（即[編纂][編纂]每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）計算，我們估計將收取的[編纂][編纂]淨額為[編纂]港元。

下表載列未來五年[編纂][編纂]淨額用途概要。該等計劃乃基於假設而定，並受不確定因素（包括「風險因素」一節所述者）影響。因此，我們無法向閣下保證我們的計劃將如期進行或我們的目標將能完全達成。

	2026年 至2027年	2028年 至2029年	2030年 至2031年	2026年 至2031年總計	佔[編纂] [編纂]淨額 總額百分比
	港元	港元	港元	港元	%
	(以百萬計，百分比除外)				
增強我們的核心技術 及研發能力.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
加強與上下游合作夥伴 的協作.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擴張我們的全球版圖及 加強國際品牌知名度...	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
營運資金及其他一般 企業用途.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	100.0%

根據我們的戰略，我們計劃按以下所載用途及金額使用[編纂][編纂]淨額：

- [編纂]淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用於增強我們的核心技術及研發能力，重點開發及迭代下一代關鍵IP，以進一步鞏固我們在高速數據接口IP、高速存儲接口IP及芯粒互連IP領域的領先地位；
- [編纂]淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用於加強與上下游合作夥伴的協作，以建立安全、可控且高效的閉環產業生態系統；
- [編纂]淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用於擴張我們的全球版圖及加強國際品牌知名度；及
- [編纂]淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。

概 要

股息政策

我們為一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司。根據中國公司法，中國註冊成立的公司須於彌補根據中國公認會計原則釐定的過往年度的累計虧損(如有)後，將其每年除稅後利潤的至少10%繳入若干法定公積金，直至該等公積金的供款總額達到其註冊資本的50%。公司在彌補累計虧損及向上述法定公積金供款後可以稅後利潤派付股息。據我們的中國法律顧問告知，除非我們有合法可供分派的溢利及儲備，否則不會宣派或派付股息。我們日後產生的任何淨利潤必須首先用於彌補過往累計虧損(如有)，其後，我們須將淨利潤的10%分配至法定公積金，直至有關公積金達到註冊資本的50%以上。

於往績記錄期間，我們並無宣派任何股息，且目前並無正式股息政策。未來三年的股息政策將由董事基於我們的盈利能力、現金流量狀況、未來資本支出需求及經營發展需求釐定。

[編纂]開支

基於[編纂]中位數每股股份[編纂]港元，假設概無根據[編纂]發行新股，有關[編纂]的估計[編纂]總額為[編纂]百萬港元。有關估計[編纂]總額包括(i)[編纂]相關開支約[編纂]百萬港元；(ii)我們法律顧問及申報會計師的費用及開支約[編纂]百萬港元；及(iii)其他費用及開支[編纂]百萬港元。

直至2025年12月31日，[編纂]開支[編纂]百萬港元計入我們的綜合損益表，而截至2025年12月31日，預付款項中[編纂]百萬港元確認為將資本化的[編纂]開支，且有關款項預計將於[編纂]後直接確認為自權益扣減。

我們預計將產生額外[編纂]開支[編纂]百萬港元，其中[編纂]百萬港元預計將計入我們的綜合損益表及[編纂]百萬港元將自權益扣除。

近期發展

業務發展。自2026年1月1日起及直至最後實際可行日期，我們訂立了兩份合約價值為人民幣10.0百萬元或以上的業務合約，佔該期間我們新簽署業務合約總價值的69.2%。按業務線劃分，芯片交付的合約價值佔我們新簽署業務合約的61.9%。按服務應用類型劃分，AI ASIC項目的合約價值佔我們新簽署業務合約總價值的82.6%。

[編纂]融資。我們於2026年1月完成C輪融資，籌資總額為人民幣416.0百萬元。

研發。自2026年1月1日及直至最後實際可行日期，我們在研發方面取得多項進展。

- LPDDR5x，我們基於國內先進工藝節點的專有高速存儲接口IP已於2026年3月提交予晶圓代工廠進行流片。
- 我們的專有3D存儲控制器IP已成功開發並授權予一名客戶。

概 要

- ONFI 5.1，我們基於國內工藝節點的專有高速存儲接口IP已成功開發並授權予一名客戶。
- 基礎IP研發已完成首個芯片上電調試及測試，各項性能參數均有顯著提升。相關方法學持續優化，更多IP計劃於2026年第二季度進行流片。
- 我們已開始對高速存儲接口IP LPDDR6進行初步研發。

無重大不利變動

董事確認，直至本文件日期，自2025年12月31日（即本文件附錄一所呈報期間的結束日期）以來，我們的財務狀況或前景並無重大不利變動，且自2025年12月31日以來，概無發生會對本文件附錄一會計師報告所載資料造成重大影響的事件。